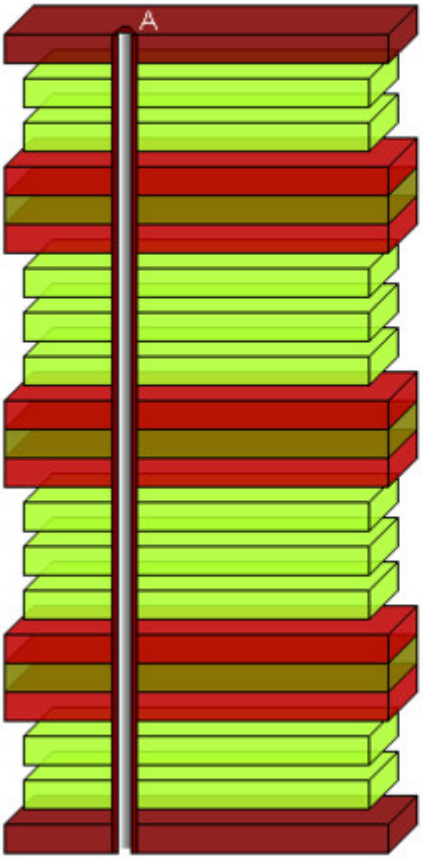
Dickkupfer-Multilayer 8 Lagen - 3,0 mm

Lagenaufbau



Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
	Cu+galv.Cu		70+25	
1	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
	Cu		105	
2	Tr-Lam	0.20		
	Cu		105	
3	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
	Cu		105	
4	Tr-Lam	0.20		
	Cu		105	
5	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
	Cu		105	
6	Tr-Lam	0.20		
	Cu		105	
7	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
	Cu+galv.Cu		70+25	
8				

Presslingsdicke*	2,89	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske*	3,00	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Dickkupfer-Multilayer 8 Lagen - 3,0 mm

- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 500 µm
	Viapad-Ø	≥ 950 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 50 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 50 µm Grundkupfer	≥ 160 µm ≥ 215 µm
Standard	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥200 µm ≥ 260 µm
	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥250 µm ≥ 320 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 145 µm ≥ 150 µm
Standard	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥175 µm ≥ 190 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com